

中信证券股份有限公司
关于
上海燧原科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
之
上市保荐书

保荐人（主承销商）



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二六年六月

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书所有简称释义，如无特别说明，均与招股说明书一致。

目 录

声 明	1
目 录	2
第一节 发行人基本情况	3
一、发行人基本信息	3
二、发行人主营业务	3
三、发行人的核心技术	3
四、发行人的研发水平	10
五、主要经营和财务数据及指标	10
六、发行人存在的主要风险	11
第二节 本次证券发行情况	20
一、本次证券发行基本情况	20
二、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况	20
三、保荐人与发行人存在的关联关系	22
四、保荐人内部审核程序和内核意见	23
第三节 保荐人承诺事项	24
第四节 保荐人对本次证券发行上市的推荐意见	25
一、本机构对本次证券发行的推荐结论	25
二、发行人就本次证券发行履行的决策程序	25
三、发行人符合科创板定位要求	26
四、保荐人对发行人符合上市条件的说明	28
第五节 上市后持续督导工作安排	32

第一节 发行人基本情况

一、发行人基本信息

公司名称：上海燧原科技股份有限公司

英文名称：Shanghai Enflame Technology Co., Ltd.

注册资本：38,731.6555 万元

法定代表人：张亚林

有限公司成立日期：2018 年 3 月 19 日

股份公司成立日期：2023 年 12 月 20 日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-522 室

邮政编码：201203

联系电话：021-6110 9566

互联网址：www.enflame-tech.com

电子信箱：IR@enflame-tech.com

经营范围：一般项目：集成电路、计算机硬件研发、批发、零售，自有研发成果转让，并提供相关技术咨询与技术服务；计算机软件（音像制品、电子出版物除外）的开发、设计、制作、批发、零售，销售自产产品；计算机硬件及辅助设备、外围设备的批发、零售、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务；集成电路制造（分支机构经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本次证券发行的类型：首次公开发行股票并在科创板上市

公司董事会办公室负责信息披露和投资者关系管理事务，负责人为黄凯然，联系电话：021-6110 9566（分机号：8999）

二、发行人主营业务

公司是我国云端 AI 芯片领域的领军企业之一，致力于成为“通用人工智能基础设施领军企业”。公司坚持原始创新、自主研发的技术路线，构筑长期可持续发展的核心

竞争力和护城河。成立 8 年来，公司自研迭代了四代架构 5 款云端 AI 芯片，构建了覆盖 AI 芯片、AI 加速卡及模组、智算系统及集群和 AI 计算及编程软件平台的完整产品体系。

核心技术领域，公司经过多年积累，形成了芯片及硬件、软件及编程平台和算力集群方案三大类，全方位、立体化的核心技术体系。底层硬件方面，公司基于自主指令集，对标英伟达的 Tensor Core 加速计算单元和 NVLink 卡间互联技术，原创自主架构的 GCU-CARE 加速计算单元和 GCU-LARE 片间高速互连技术，相应架构不仅具有编程灵活性，而且深度支持 AI 大模型高并行度加速计算。软件平台层面，公司未跟随英伟达主导的 CUDA 生态，自研了包括驱动程序、编译语言与编译器、算子库、工具链的全栈 AI 计算及编程软件平台“驭算 TopsRider”，以链接公司硬件与人工智能应用程序，大大降低了主流 AI 模型的编程开发难度和迁移成本，能够让公司硬件产品在实际场景中更好地释放性能。算力集群方面，公司报告期内千卡、万卡智算中心项目已经实现收入，目前公司已经联合客户研发超节点方案，联合打造具有商业化价值的万卡高速互联集群。

生态建设上，受益于与互联网大厂多年在软硬件定制化方面的深耕合作，公司多代产品已在广泛的互联网 AI 场景中大规模商用，持续为基于从传统 AI 模型到 AI 大模型的国民级互联网应用提供 AI 算力支撑。公司的产品持续迭代开发能力以及产品竞争力已经得到市场的检验和认可，正逐步实现从“技术产品闭环”到“商业价值闭环”的关键跨越。此外，公司也正充分发挥自身优势，与下游更广泛的合作伙伴共建生态。除参与国家“东数西算”枢纽节点的智算中心项目外，公司正积极深化与国内电信运营商的合作，并开拓多条垂类行业的业务机会，为 AI 赋能千行百业提供普惠的算力支持。此外，为实现可持续发展，燧原科技高度重视与 EDA/IP、晶圆制造、封装测试、系统元器件等全产业链条伙伴的长期战略合作，保障稳定的产品开发与供给交付。

截至 2025 年末，公司已获得境内发明专利 313 项，已承担 12 项国家及地方科技攻关项目，参与了 58 项 AI 芯片与智算系统的关键国家及行业标准的制定，获得世界人工智能大会“SAIL 之星”、中国算力大会“年度突破成果”、三次“中国芯”最高奖“年度重大创新突破产品”“吴文俊人工智能科学技术专项一等奖”、全球“未来产业之星”大赛未来产业超能奖等重要奖项。此外，公司申报的“基于燧原万卡集群的先进计算技术底座实践”成功入选工信部 2025 年计算技术底座典型应用案例。公司庆阳万

卡集群亦为国内首个获中国信通院大规模智算集群服务成熟度五星级认证的国产万卡推理集群，充分印证了公司在国产算力底座建设与产业化落地方面的领先实力。

报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

三、发行人的核心技术

公司始终坚持原始创新，将研发实力和创新能力作为公司可持续发展的核心竞争力，通过多年积累形成了芯片及硬件、软件及编程平台和算力集群方案三大类，全方位、立体化的核心技术体系。基于上述软硬件技术和系统方案的有机组合，一方面公司产品实测性能获得突破。公司最新的第四代 AI 加速卡在 2025 年官方机构专项测试中，取得良好成绩，部分测试指标已与国际竞品性能相近。另一方面，公司产品商业化加速落地，已在互联网厂商的多个 AI 应用业务场景大规模部署。公司核心技术具体如下：

核心技术名称	技术来源	应用的量产产品或服务	所处阶段	已授权发明专利数量	技术先进性
原始创新、自主结构的高性能芯片与硬件技术	自主研发	公司一至四代云端 AI 芯片及相应 AI 加速卡及模组产品	成熟应用，不断迭代	108	国内领先
不依赖 CUDA 生态的 AI 计算软件及编程平台技术		基于公司芯片打造的 AI 计算及编程软件平台驭算 TopsRider		93	
高速互联、稳定可靠的 AI 算力集群方案技术		结合公司软硬件打造的智算系统及集群方案		17	

（一）原始创新、自主结构的高性能芯片与硬件技术

公司未跟随英伟达的 GPGPU 架构，而是基于自主指令集，对标英伟达的 Tensor Core 加速计算单元和 NVLink 卡间互联技术，原创自主架构的 GCU-CARE 加速计算单元和 GCU - LARE 片间高速互连技术，相应架构不仅具有编程灵活性，而且深度支持 AI 大模型高并行度加速计算。公司最新的第四代云端 AI 芯片，是国内少有的原生支持 FP8 低精度数据的产品，部分指标和实测性能可对标国际竞品，支持超节点方案和万卡及以上算力集群方案，充分说明该核心技术已达到国内领先水平。具体包括：

基于自研指令集体系的 GCU-CARE 加速计算单元：公司自研 AI 计算指令集体系涵盖计算、控制、缓存访问、数据同步等功能，在此基础上研发出适用于复杂 AI 计算任务高效并行处理与硬件加速的 GCU-CARE 加速计算单元。截至本招股说明书签署日，

GCU-CARE 加速计算单元微结构已迭代四代，最新第四代结构原生支持 **FP8** 等多种精度数据的混合计算，兼具硬件通用性和对 **AI** 计算的加速优化。公司是国内少有的产品实现原生支持 **FP8** 数据精度的厂商，能够在更少占用内存的情况下显著提升计算速度、数据吞吐量和计算能效，更好支持 **DeepSeek** 满血版大模型，有效满足快速增长的大规模训练和推理算力需求。

自主架构的 GCU - LARE 片间高速互连技术：**AI** 大模型参数迈入千亿，甚至万亿规模，单芯片算力性能的提升已经无法支持大规模训练和推理的算力需求，算力集群规模从千卡演进至万卡乃至十万卡成为技术趋势，这需要 **AI** 芯片底层原生支持卡间高速互连。公司自主研发的 **GCU - LARE** 高速互连技术采用自主创新架构设计，支持多个 **AI** 芯片直接互联拓扑，突破了传统 **PCIe** 总线在带宽和延迟方面的限制，通过兼容能快速适配国内外主流算力集群组网方案，可通过网络设备组建超节点及万卡以上大规模算力集群。

先进封装工艺设计：**AI** 芯片单颗面积大，生产良率低，需要先进封装工艺实现同构和异构集成，大幅提升芯片的算力性能、显存带宽和整体能效比。公司第三代芯片通过 **Chiplet** 互联协议，实现两颗芯片同构合封，用可控的成本实现算力性能翻倍。公司 **2019** 年发布第一代芯片即采用异构集成的先进封装方案，不断优化自身的超高密度布线技术与微凸点集成技术，公司第四代芯片已经实现全国产先进封装方案。

高性能 AI 芯片的架构设计、功耗管理及验证技术：首先，公司高性能 **AI** 芯片架构设计采用高集成度、高性能和模块化的 **SoC** 架构设计方案，集成了大量的 **GCU-CARE** 加速计算单元、**CPU** 控制、多级缓存、功耗管理以及接口 **IP** 模块，实现了从 **IP** 到 **SoC** 再到芯片组的无缝集成，能够针对不同应用场景和产品形态进行灵活配置。其次，公司具有的高性能芯片内总线、多级缓存架构及内存管理技术，实现了对片内缓存与显存资源的精细化管理与高效调度，具备显著降低访存延迟和提升数据复用率的特点。第三，公司低功耗设计和高性能动态功耗管理技术针对 **AI** 芯片的负载和架构特性，可实现自适应动态电压与频率实时调节，有效提升芯片在复杂应用场景下的能效比。最后，公司结合 **AI** 芯片存储密度高、结构复杂等特征进行自主创新，通过验证流程前移、资源复用与多阶段协同测试方案，提升验证覆盖率与效率，为复杂芯片的功能正确性与量产可行性提供可靠保障，公司设立以来四代 **5** 款芯片均一次流片成功。

高性能 AI 加速模组设计技术：对于多卡高速互连，如果采用传统的 **AI** 加速卡（即

标准 PCIe 板卡)，卡间互联还额外需要 PCIe 连接器，相应数据信号存在传输损耗大，互联速度受限的难题。公司是国内首家自主研发了高密度、高互联带宽的 OAM 模组方案，多卡之间直接可通过 UBB 底座进行信号互相传输，具有传输损耗低、充分释放互联带宽的特点。此外，公司也在 OAM 模组方案中自主设计了更先进的冷板与液冷耦合方案，在 95° C 结温限制下，能保障芯片持续满频运行不降频。

（二）不依赖 CUDA 生态的 AI 计算软件及编程平台技术

公司坚持独立自主、开放创新的软件生态战略，未跟随英伟达主导的 CUDA 软件生态，自研了包括驱动程序、编译语言与编译器、算子库、工具链、深度学习框架的全栈 AI 计算及编程软件平台驭算 TopsRider，以链接公司硬件与人工智能应用程序，大大降低了 AI 大模型的编程开发难度和迁移成本，能够让公司硬件产品在实际场景中更好地释放性能。公司硬件产品已经深度适配，并支持了 AI 智能搜索、大模型业务平台、智能语音交互、智能内容推荐等 AI 应用场景，充分说明了该核心技术的国内领先性。具体包括：

AI 加速系统驱动技术：驱动程序是公司硬件到软件应用的第一层桥梁，负责把操作系统/软件应用的标准功能转化为公司硬件功能，同时也把公司硬件运行状态反馈给上层应用。公司的 AI 加速系统驱动技术适配主流及国产操作系统，集成硬件管理、系统虚拟化、高性能任务调度与高可靠故障处理等核心功能，具备兼容性、安全性以及支持算力集群大规模部署的特点。

AI 加速编程语言和编译器技术：AI 应用开发者用高级编程语言编写的程序源代码经编译器编译生成相应底层代码，经过运行时系统加载后可以在硬件和主机系统上执行。公司具有对标英伟达 CUDA 编程体系的全自研 Tops C++编程语言、完备的编译器工具链的编程开发平台，具备高效、易用和便于 CUDA 程序迁移的特点，可充分挖掘公司硬件性能，显著提升 AI 模型执行效率。

广泛且深度优化的 AI 加速算子库和通信库：截至本上市保荐书签署日，公司已提供约 1,600 个优化算子，全面覆盖线性代数、深度学习、视觉处理等算子库，使开发者无需从底层开始编写复杂的代码，而是能够直接调用相关 AI 加速算子应用，提高 AI 应用开发效率。在公司产品商业化落地过程中，公司算子库已帮助数千个 AI 模型实现业务上线，泛化性和稳定性已得到大规模业务验证。此外，公司通过提供高度优化的

AI 加速通信库、共享内存库等核心组件，可更好实现了 AI 算力集群中跨卡、跨节点的高速、低延迟数据通信，具备支持复杂互连拓扑、大规模分布式训练与推理任务的特点。

无缝支持主流深度学习框架和推理引擎：驭算(TopsRider)已经无缝支持 PyTorch、TensorFlow、vLLM、SGLang、Megatron-LM、DeepSpeed 等主流深度学习与分布式训练框架和高性能的推理引擎，为开发者提供了易用度高、迁移成本低的开发环境，以及快速部署的能力，具备生态兼容性好、性能卓越及能快速适配前沿模型的特点。

（三）高速互联、稳定可靠的 AI 算力集群方案技术

AI 应用带来的大规模训练和推理的算力需求，算力集群规模从千卡演进至万卡乃至十万卡成为技术趋势，集群数量的累积并非技术先进性的体现，实测的互联效率、是否适配大模型的互联结构化方案以及互联运行的稳定性是商业化落地的核心因素。公司报告期内千卡、万卡智算中心项目已经实现收入，目前公司已经联合客户研发超节点方案，并联合打造具有商业化价值的万卡高速互联集群方案，充分说明该核心技术已达到国内领先水平。具体包括：

算力集群高速互联技术：在芯片原生架构支持的基础上，公司基于 RoCEv2 的高性能互连方案及可扩展的集群网络架构，构建了支撑万卡级 AI 算力集群的高速通信基础，具备超高带宽、超低延迟、高可靠性及智能网络管控的特点。公司的高速互联方案不仅支持 Scale-up 网络支持超节点弹性扩展，同时支持 Scale-out 万卡集群互联，满足大模型训练与推理的通信需求。

分布式计算并行策略及性能优化技术：随着 DeepSeek 等基于稀疏 MoE（混合专家）结构的大模型逐渐成为行业主流，AI 推理的计算范式正发生深刻变革。专家并行、参数解耦与数据并行分离（PD 分离）等新型推理架构，日益成为提升 MoE 模型推理效率的关键技术路径。这意味着可将 AI 推理任务分解成不同算力特性的子任务，分配给算力集群中的不同算力节点并行处理，提升整体效率。公司的分布式 AI 计算性能优化技术全面支持专家并行、上下并行、数据并行、流水线等并行策略，可针对不同模型配置最优化的并行方案。同时在并行策略基础上，可实施通信优化、显存压缩、负载均衡等一系列协同优化技术，整体提升算力集群对大模型的并行计算性能。

集群运维及部署技术：公司通过提供集群资源监控、智能调度、自动化部署与故障诊断于一体的全栈管理平台，实现了对大规模智算集群的高效、稳定运维，具备运维自

动化、管理精细化及大幅降低运营成本的特点。目前公司已经可以实现千卡算力集群 7 天高性能稳定运行，万卡算力集群 24 小时无故障稳定运行，相应指标在国内处于领先地位。

公司未跟随英伟达的 GPGPU 架构，而是基于自主指令集，对标英伟达的 Tensor Core 加速计算单元和 NVLink 卡间互联技术，原创自主架构的 GCU-CARE 加速计算单元和 GCU - LARE 片间高速互连技术，相应架构不仅具有编程灵活性，而且深度支持 AI 大模型高并行度加速计算。公司最新的第四代云端 AI 芯片，是国内少有的原生支持 FP8 低精度数据的产品，部分指标和实测性能可对标国际竞品，支持超节点方案和万卡及以上算力集群方案，充分说明该核心技术已达到国内领先水平。具体包括：

基于自研指令集体系的 GCU-CARE 加速计算单元：公司自研 AI 计算指令集体系涵盖计算、控制、缓存访问、数据同步等功能，在此基础上研发出适用于复杂 AI 计算任务高效并行处理与硬件加速的 GCU-CARE 加速计算单元。截至本上市保荐书签署日，GCU-CARE 加速计算单元微结构已迭代四代，最新第四代结构原生支持 FP8 等多种精度数据的混合计算，兼具硬件通用性和对 AI 计算的加速优化。公司是国内少有的产品实现原生支持 FP8 数据精度的厂商，能够在更少占用内存的情况下显著提升计算速度、数据吞吐量和计算能效，更好支持 DeepSeek 满血版大模型，有效满足快速增长的大规模训练和推理算力需求。

自主架构的 GCU - LARE 片间高速互连技术：AI 大模型参数迈入千亿，甚至万亿规模，单芯片算力性能的提升已经无法支持大规模训练和推理的算力需求，算力集群规模从千卡演进至万卡乃至十万卡成为技术趋势，这需要 AI 芯片底层原生支持卡间高速互联。公司自主研发的 GCU - LARE 高速互连技术采用自主创新架构设计，支持多个 AI 芯片直接互联拓扑，突破了传统 PCIe 总线在带宽和延迟方面的限制，通过兼容能快速适配国内外主流算力集群组网方案，可通过网络设备组建超节点及万卡以上大规模算力集群。

先进封装工艺设计：AI 芯片单颗面积大，生产良率低，需要先进封装工艺实现同构和异构集成，大幅提升芯片的算力性能、显存带宽和整体能效比。公司第三代芯片通过 Chiplet 互联协议，实现两颗芯片同构合封，用可控的成本实现算力性能翻倍。公司 2019 年发布第一代芯片即采用异构集成的先进封装方案，不断优化自身的超高密度布线技术与微凸点集成技术，公司第四代芯片已经实现全国产先进封装方案。

高性能 AI 芯片的架构设计、功耗管理及验证技术：首先，公司高性能 AI 芯片架构设计采用高集成度、高性能和模块化的 SoC 架构设计方案，集成了大量的 GCU-CARE 加速计算单元、CPU 控制、多级缓存、功耗管理以及接口 IP 模块，实现了从 IP 到 SoC 再到芯片组的无缝集成，能够针对不同应用场景和产品形态进行灵活配置。其次，公司具有的高性能芯片内总线、多级缓存架构及内存管理技术，实现了对片内缓存与显存资源的精细化管理与高效调度，具备显著降低访存延迟和提升数据复用率的特点。第三，公司低功耗设计和高性能动态功耗管理技术针对 AI 芯片的负载和架构特性，可实现自适应动态电压与频率实时调节，有效提升芯片在复杂应用场景下的能效比。最后，公司结合 AI 芯片存储密度高、结构复杂等特征进行自主创新，通过验证流程前移、资源复用与多阶段协同测试方案，提升验证覆盖率与效率，为复杂芯片的功能正确性与量产可行性提供可靠保障，公司设立以来四代 5 款芯片均一次流片成功。

高性能 AI 加速模组设计技术：对于多卡高速互联，如果采用传统的 AI 加速卡（即标准 PCIe 板卡），卡间互联还额外需要 PCIe 连接器，相应数据信号存在传输损耗大，互联速度受限的难题。公司是国内首家自主研发了高密度、高互联带宽的 OAM 模组方案，多卡之间直接可通过 UBB 底座进行信号互相传输，具有传输损耗低、充分释放互联带宽的特点。此外，公司也在 OAM 模组方案中自主设计了更先进的冷板与液冷耦合方案，在 95° C 结温限制下，能保障芯片持续满频运行不降频。

四、发行人的研发水平

截至 2025 年末，公司已获得境内发明专利 313 项，已承担 12 项国家及地方科技攻关项目，参与了 58 项 AI 芯片与智算系统的关键国家及行业标准的制定，获得世界人工智能大会“SAIL 之星”、中国算力大会“年度突破成果”、三次“中国芯”最高奖“年度重大创新突破产品”“吴文俊人工智能科学技术专项一等奖”、全球“未来产业之星”大赛未来产业超能奖等重要奖项。此外，公司申报的“基于燧原万卡集群的先进计算技术底座实践”成功入选工信部 2025 年计算技术底座典型应用案例。公司甘肃庆阳万卡集群亦为国内首个获中国信通院大规模智算集群服务成熟度五星级认证的国产万卡推理集群，充分印证了公司在国产算力底座建设与产业化落地方面的领先实力。

五、主要经营和财务数据及指标

报告期内，发行人主要经营和财务数据及指标如下：

单位：万元，如无特殊说明

项目	2025.12.31 /2025 年度	2024.12.31 /2024 年度	2023.12.31 /2023 年度
资产总额	452,230.52	582,728.74	254,055.19
归属于母公司股东/所有者权益	314,736.21	416,098.10	202,788.08
资产负债率（母公司）	24.05%	20.81%	7.08%
资产负债率（合并）	30.40%	28.59%	20.18%
营业收入	99,016.00	72,238.74	30,118.74
净亏损	-116,388.10	-151,031.58	-166,459.08
归属于母公司股东/所有者的净亏损	-116,388.10	-151,031.58	-166,459.08
扣除非经常性损益后归属于母公司 股东/所有者的净亏损	-119,726.11	-150,269.38	-156,668.54
基本每股收益（元/股）	-3.00	-4.61	-5.41
稀释每股收益（元/股）	-3.00	-4.61	-5.41
加权平均净资产收益率	-31.85%	-87.98%	-211.52%
经营活动产生现金流量净额	-96,508.71	-179,773.78	-120,900.41
现金分红	-	-	-
研发投入占营业收入比例	114.63%	181.66%	408.01%

六、发行人存在的主要风险

（一）与发行人相关的风险

1、国产 AI 算力行业尚处于发展初期，且云端 AI 芯片具有研发投入大、客户验证和适配周期长的特点，公司收入尚未充分释放。报告期内公司扣除非经常性损益后尚未实现盈利，最近一期期末存在未弥补亏损

报告期各期，公司营业收入分别为 30,118.74 万元、72,238.74 万元和 99,016.00 万元，扣除非经常性损益后净利润分别为-156,668.54 万元、-150,269.38 万元和 -119,726.11 万元，尚未实现盈利。

公司报告期内尚未实现盈利，主要原因为：1）云端 AI 芯片硬件上需要先进的晶圆制造和封装测试工艺，以年为单位快速迭代产品；软件上需要构建并不断完善 AI 计算及编程软件平台，确保深度支持持续迭代的主流 AI 大模型；同时还需要与供应链伙伴联合研发，保障供应链稳定。前述因素导致研发投入巨大；2）公司面对互联网大厂需

求，需要联合验证打磨多代产品，不断软件适配优化以满足业务场景需求，实现产品方案与客户商业价值匹配，方可逐步放量部署。

报告期内，公司收入规模尚未充分释放，无法覆盖刚性研发投入，制约了公司短期盈利能力。截至 2025 年末，公司合并和母公司口径未弥补亏损分别为-444,076.65 万元和-200,140.20 万元。如果公司持续亏损，将可能对公司经营发展产生不利影响，公司也无法对投资者分红。

2、报告期内公司对终端第一大客户腾讯关联销售金额持续增长且收入占比较高的风险

报告期各期，公司对腾讯科技（深圳）的直接销售和对应的 AVAP 模式销售合计收入分别为 10,042.02 万元、27,282.50 万元和 82,965.20 万元，同期营业收入占比分别为 33.34%、37.77%和 83.79%。鉴于腾讯科技（深圳）为公司关联方，公司对腾讯科技（深圳）直接销售和 AVAP 模式销售均构成关联交易。若按终端客户统计，腾讯为发行人报告期各期第一大客户，公司对腾讯关联销售金额持续增长且收入占比较高。

公司与腾讯于 2019 年起开始合作，双方围绕业务场景适配优化、AI 模型性能调优、配套软件栈完善等关键领域，共同投入大量资源持续打磨软硬件产品性能。期间历时 7 年，从单一场景小规模验证到多场景大规模验证，再到常态化批量合作。公司产品已在腾讯大量 AI 业务场景中实现规模化部署，双方已形成深度合作关系，报告期内公司对腾讯关联销售金额持续增长。

报告期内，腾讯对 AI 加速卡的需求规模远超公司目前供应能力；同时，公司秉承“优先单点突破、后续以点带线、逐步以线带面”的客户战略，将有限资源聚焦腾讯，优先在头部互联网客户的海量、高并发、高要求的真实业务场景中快速提升产品和技术能力，报告期内公司对腾讯收入占比较高。鉴于腾讯为国内 AI 算力的主要需求方，公司预计未来一段时期内对腾讯销售占比较高的情形仍将持续。

若未来公司产品无法紧跟 AI 需求有效迭代，无法满足腾讯技术需求；或国内 AI 技术和应用发展放缓导致国内头部互联网厂商 AI 资本开支下调；或公司未来新客户拓展不达预期，且腾讯采购策略发生重大变化，双方合作关系被其他供应商所取代等，前述情况均可能导致腾讯减少对公司产品的采购规模或调低对公司产品的采购定价，将对公司未来业务发展及经营业绩产生不利影响。

3、报告期内公司产品主要用于推理场景，由于第四代训推一体产品尚未大规模交付，公司产品在 AI 大模型训练场景尚未广泛落地

考虑国际厂商在 AI 应用领域的先发优势，公司总体采用“训练产品逐步探索，推理产品迅速推进”的产品迭代路径。该策略是基于训练卡作为 AI 大模型研发的基础设施，追求极致性能与高稳定性，该场景由国际厂商产品主导。推理卡作为 AI 大模型服务的交付载体，更注重部署成本与场景适配效率，商业化落地更快，报告期内公司专注推理产品是能够快速实现自我造血反哺训练产品持续投入的务实选择。

报告期内公司 AI 加速卡及模组收入 80%以上为推理产品，国内可比公司 AI 加速卡及模组收入 50%以上为训练/训推一体产品（但仍主要用于客户推理场景）。基于客户对推理场景部署成本的极致要求，公司的 AI 推理产品硬件配置和性能相对训练/训推一体产品适度裁剪，产品结构差异导致公司 AI 加速卡及模组单价和毛利率低于国内可比公司的 AI 加速卡产品。公司第四代产品 L600 为训推一体加速模组，截至招股书签署日，该产品已回片但尚未大规模量产交付。公司已经联合客户基于第四代产品积极推进 AI 大模型的训练领域应用研发，但尚未广泛落地。若公司第四代产品未能按规划大规模量产交付，将对公司产品在 AI 大模型训练场景广泛落地、超节点智算系统产品推出等方面产生不利影响，进一步对盈利能力和持续经营能力产生影响。

4、公司产品研发迭代的风险

云端 AI 芯片具有研发投入大、技术复杂度高和迭代周期快的特点。一方面，AI 大模型计算范式和算法结构不断演变，国际主流 AI 大模型的技术演变方向和应用场景往往决定了新一代云端 AI 芯片的产品规格；另一方面，云端 AI 芯片的硬件架构、制程工艺、封装工艺、存储及互联方案以及软件生态等各环节关键技术均处于快速演变过程中。

在高强度研发投入过程中，公司可能受到技术路线、工程实现难度、设计验证、良率爬坡、软硬件协同优化以及量产推进等多方面因素影响。若公司在关键技术方向判断、产品架构规划或研发节奏把控方面未能达到预期，导致研发成果性能指标不及市场需求、产品交付进度滞后，或相关成果未能及时实现规模化商业应用，亦或市场出现具有替代性的技术路径或产品方案，可能削弱公司产品的市场竞争力，导致研发投入无法形成预期收入，将对公司经营业绩造成不利影响。

5、实际控制人对公司控制比例不足 30%的风险

截至本上市保荐书签署日，公司实际控制人 ZHAO LIDONG、张亚林合计直接持有公司 17.9287%的股权，通过燧原汇智与燧原崇英两个员工持股平台间接控制公司 10.2070%的股权，两名实际控制人合计控制公司 28.1357%的股权，不足 30%。本次发行后，两名实际控制人可支配的公司表决权比例将被进一步稀释，可能会对公司的控制权稳定造成不利影响。

6、募投项目相关风险

本次募集资金投向的五代 AI 芯片系列产品与六代 AI 芯片系列产品，系对现有产品体系的拓展与升级迭代。公司已就本次募集资金投资项目的必要性与可行性进行充分论证与审慎决策，综合考量行业发展趋势、市场环境、下游客户需求、公司现有技术研发实力及中长期发展战略等多重因素，对项目实施的可行性与预期效益进行全面评估。若项目实施过程中，前述相关因素发生重大不利变化，或新产品、新技术研发进度及市场推广不及预期，最终可能影响募集资金投资项目预期收益的实现。同时，本次募集资金投资项目在实施过程中将新增较大规模的研发投入、固定资产折旧和无形资产摊销，对发行人各年度经营业绩有直接影响。由于募投项目的投入、建设及产生效益需要一定的时间周期，且若在项目实施期间，市场环境、产业政策等发生重大不利变化，或出现研发失败等情形，可能导致募投项目实际收益低于预期，则前述新增的研发投入、折旧摊销等将对发行人未来经营业绩产生不利影响。

7、存货规模较大及存货跌价风险

报告期内，因公司业务扩张以及战略性备货，存货规模逐年上升。报告期存货账面余额分别为 26,142.90 万元、97,939.23 万元和 107,427.83 万元。考虑到云端 AI 芯片技术迭代快，公司根据报告期各期销售预期对存货谨慎计提跌价损失。报告期内，公司存货跌价损失金额分别为 12,775.16 万元、3,027.83 万元和 3,160.62 万元。

若外部市场环境发生重大不利变化、行业竞争加剧、公司产品迭代速度落后于同业或产品供过于求而导致单价下跌，公司存货的可变现净值可能显著降低，公司可能面临存货跌价损失增加从而影响经营业绩。另一方面，若未来公司不能有效拓宽销售渠道、优化库存管理，导致出现大规模存货积压情形，可能对公司营运资金周转造成不利影响。

8、应收账款坏账风险

报告期内，随着公司业务扩张，应收账款保持一定规模，各期末应收账款账面余额分别为 24,743.24 万元、51,796.58 万元和 29,048.30 万元，公司按照客户不同信用风险特征对应收账款计提坏账准备，各期末应收账款坏账准备计提比例分别为 6.45%、8.73%和 24.76%。截至本上市保荐书签署日，报告期末的部分应收账款尚未完成回款，如对应客户财务状况恶化或付款进度不及预期，相关应收账款可能面临无法全部收回的风险。

9、预付款项规模较大的风险

公司主要供应商选择范围有限，集中度高，采购时通常需要支付较高比例的预付款。随着公司业务扩张及战略备货，预付账款余额持续增加，报告期各期末公司预付款项金额分别为 20,353.39 万元、12,756.99 万元和 38,813.22 万元。若上游供应商因经营恶化或不可抗力导致无法履约交货，公司可能面临预付款项无法收回风险。此外，随着公司未来业务持续扩大，若关键供应商要求较大比例预付或延长供货周期，可能对公司营运资金周转造成不利影响。

10、经营业绩季节性风险

报告期内，公司主营业务收入因客户采购规划及市场需求等因素而存在一定季节性。2023 年至 2025 年，公司第四季度主营业务收入占全年主营业务收入的比例分别为 77.18%、89.05%、45.59%。公司提醒投资者不宜以季度数据简单推算公司全年经营业绩。

11、经营活动现金流持续为负的风险

报告期各期，由于关键物料备货导致存货和预付账款规模较大，公司经营活动产生的现金流量净额持续为负，各期分别为-120,900.41 万元、-179,773.78 万元和 -96,508.71 万元。

公司所处行业具有关键环节采购预付比例较高、从原材料采购到货至最终产品交付环节多、交付周期长等特点。随着公司业务规模持续扩张，存在未来一段时间内公司经营活动现金流持续为负的可能性。若公司无法通过股权或债务融资等方式合理筹措流动资金，有效改善现金流，则在营运资金周转方面将会面临一定风险。

12、规模增长带来的管理风险

报告期内，随着公司的业务体量和资产规模不断扩张，在研发、采购、销售等环节的资源配置和内控管理的复杂程度也在不断提升，对公司组织架构和管理层的挑战和能力要求不断加强。若公司的组织模式和经营管理制度未能随着公司业务规模的扩大及时调整与完善，未能建立起高效的运营模式，公司将面临规模扩张导致的管理和内控风险，从而给公司的稳定发展带来不利影响。

13、商标纠纷风险

发行人的注册商标是发行人品牌形象的重要组成部分，发行人的注册商标依法注册、合法使用，发行人对该等注册商标享有法定权利。报告期内，发行人存在所拥有的少数商标被第三方向国家知识产权局申请宣告无效以及提出因无正当理由三年未使用撤销商标申请的情形。截至本上市保荐书签署日，前述撤销商标申请已全部或部分被国家知识产权局驳回，且存在争议的商标未用于发行人主营业务，该等商标争议对公司主营业务造成的不利影响有限。若公司与第三方公司存在争议的商标最终被宣告无效，将影响发行人对该等商标的使用。

14、舆情相关风险

随着业务发展及产品影响力的提升，公司持续受到媒体关注和报道。虽然公司已持续关注各类媒体报道并进行舆情管理工作，但未来若出现有关公司的重大负面不实报道而公司未及时核实说明，将对公司的经营发展产生不利影响。

15、离职员工股权激励纠纷的风险

截至本上市保荐书签署日，公司与 1 名离职员工对已授予激励股权离职后的处置存在争议，所涉及激励份额对应公司股数约占目前公司总股本的 0.0464%。相关争议主要系公司根据股东会审议通过的股权激励管理办法，按照明确约定的价格回购离职员工所持股权激励份额，但前述离职员工以不认可回购价格等为由不配合签署相关文件或不配合办理工商变更。公司正与相关员工协商，若协商未果，公司将适时提起诉讼、仲裁解决前述争议，因此存在发生潜在诉讼、仲裁或纠纷等风险。

16、租赁相关的风险

截至本上市保荐书签署日，发行人部分租赁房屋存在未取得权属证明情形，该部分

办公场所未用于公司核心业务，租赁面积较小，可替代性强，可随时搬迁至有产权证书的地址办公，如公司需要搬迁，将可能对公司的生产经营稳定性造成影响并带来额外的搬迁支出。

（二）与行业相关的风险

1、AI 需求变化导致头部云/互联网厂商 AI 资本开支变动的风险

随着 GPT、DeepSeek、Gemini 等主流 AI 大模型快速迭代推动 AI 对话、AI 多模态应用以及 AI Agent 应用指数级增长，AI 算力需求持续攀升，驱动头部大厂 AI 资本开支不断增长。截至本招股书签署日，亚马逊、谷歌、Meta 和微软四家美国头部云厂商已将 2026 年合计资本开支上调超过 7,000 亿美元，同比 2025 年增长 70%以上，相应资本开支主要应用于 AI 领域。根据 Bernstein 报告预测，国内字节跳动、阿里巴巴和腾讯三家头部互联网厂商 2026 年 AI 资本开支合计为 560 亿美元，2028 年预计接近 1,000 亿美元，合计每年占据中国 AI 资本开支的 50%。

若因全球经济增速放缓、AI 大模型技术迭代和应用普及放缓、AI 基础设施上游供应链产能不足、各国产业政策调整或头部云/互联网厂商财务资源受限等因素导致 AI 算力需求增速放缓、AI 资本开支预算缩减或投资延后，将对公司的未来业务发展及经营业绩产生不利影响。

2、行业竞争加剧的风险

以英伟达为代表的国际厂商是全球 AI 算力的标准制定者、技术引领者和行业主导者，不论是硬件性能、软件生态，还是系统定义和集成能力均领先于国产厂商。此外，前述国际厂商利用先发优势已经与全球头部晶圆制造厂、头部存储 IDM 厂、主流 AI 大模型厂商和互联网厂商形成了不限于产能锁定、联合研发、相互投资的合作关系。2025 年，根据 IDC 数据统计，前述国际厂商占据了中国 AI 加速卡接近 60%的市场份额，已形成阶段性的垄断竞争格局。

此外，以华为海思、寒武纪为代表的国产厂商起步早于发行人，各自 AI 算力产品在国内市场已颇具规模，与发行人共同推动国内人工智能产业的发展。

面对国内外厂商竞争，若公司未能通过高效研发持续迭代推出具备竞争力的产品，未能在核心客户业务场景完成产品规模化部署与落地，未能强化资本实力并夯实技术储备，无法保障供应链稳定以实现产品及时交付，公司未来经营业绩将受到不利影响。

3、国际贸易摩擦可能产生的供应链风险

公司采用 Fabless 经营模式，需要依托晶圆制造厂、存储 IDM 厂、封装测试厂和 EDA 及 IP 厂商等产业链合作伙伴方可完成产品研发和交付。报告期内，公司在部分物料、研发设计工具和晶圆制造等关键环节可选供应主体数量有限，存在向境外供应商采购情形。尽管公司持续推进供应链多元化布局，但形成稳定的供给能力往往需要长时间的产业链协同研发，相关环节在工艺成熟度、规模化交付能力方面仍需完善。

鉴于国际贸易摩擦的持续变化和不可预测性，若外部供应链发生不利变化，导致公司供应链关键环节的供给节奏、交付条件或合作稳定性受到影响，如果公司短期内难以完成等效替代或调整安排，可能对公司产品研发和销售带来重大不利影响。

4、技术人才流失和核心技术泄密风险

公司所处行业为知识与技术密集的行业，知识产权至关重要。公司在产品研发过程中，涉及的专利及非专利技术等众多知识产权，需通过申请专利等方式保护自身核心技术并避免侵犯他人知识产权。但不能排除与竞争对手等相关方产生知识产权争议的可能性，亦不能排除公司的知识产权被竞争对手等相关方侵权的可能性，此类知识产权争议将有可能对公司的正常经营活动产生不利影响。

5、知识产权争议风险

公司所处行业为知识与技术密集的行业，知识产权至关重要。公司在产品研发过程中，涉及的专利及非专利技术等众多知识产权，需通过申请专利等方式保护自身核心技术并避免侵犯他人知识产权。但不能排除与竞争对手等相关方产生知识产权争议的可能性，亦不能排除公司的知识产权被竞争对手等相关方侵权的可能性，此类知识产权争议将有可能对公司的正常经营活动产生不利影响。

6、产业政策变化的风险

AI 算力行业是支撑国家人工智能产业发展的重要一环。该行业横跨集成电路和人工智能两个领域，是各国举国力发展的新兴战略产业。得益于国家政策支持，AI 算力行业在短短几年得到了快速发展。相关产业政策覆盖税收、人才培养、技术创新下游应用和生态完善等各方面，有效提升了行业内厂商市场竞争力和可持续发展潜力。然而，产业政策面临变化的不确定性，如未来国家相关产业政策出现不利变化，将可能一定程度上对公司业务发展、人才引进和生产经营等造成不利影响。

7、政府补助与税收优惠政策变动的风险

报告期各期，公司由政府补助确认的其他收益分别为 2,695.98 万元、2,212.87 万元和 1,741.67 万元。如果未来相关政府部门对公司所处行业的政策支持力度调整或其他产业政策发生不利变化，公司取得的政府补助金额可能有所降低，从而对公司经营业绩造成一定影响。

所得税方面，公司及部分子公司为高新技术企业，报告期内享受高新技术企业所得税优惠税率。增值税方面，根据国家有关政策，公司及部分子公司报告期内享受增值税抵减等税收优惠。未来如果相应税收优惠政策变化，或者公司不能持续获得高新技术企业资质认定，公司的盈利能力和资金周转能力将受到影响。

（三）其他风险

除上述风险因素外，投资者在评价公司本次发行的股票时，还应认真考虑整体变更存在未弥补亏损风险、发行失败风险、募投项目实施效果未达预期的风险、即期回报被摊薄与净资产收益率下降的风险、股票价格可能发生较大波动的风险、触发退市风险警示甚至退市条件的风险、安全生产、环境保护、不可抗力等风险。

第二节 本次证券发行情况

一、本次证券发行基本情况

1、证券种类：人民币普通股（A股）。

2、发行数量：不低于 4,303.5173 万股且不超过 6,834.9980 万股（不含超额配售）。

3、发行方式：本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，或中国证监会认可的其他方式。

二、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况

（一）项目保荐代表人

中信证券指定张欢、陈泽作为燧原科技首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐代表人。

张欢，男，现任中信证券股份有限公司投资银行部总监，保荐代表人。曾负责或参与的项目包括西安奕斯伟材料科技股份有限公司 IPO 项目、沈阳富创精密设备股份有限公司 IPO 项目、有研半导体硅材料股份有限公司 IPO 项目、中信金属股份有限公司 IPO 项目、长江存储科技有限责任公司财务顾问项目、中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 IPO 项目、山东新巨丰科技包装股份有限公司 IPO 项目、江苏共创人造草坪股份有限公司 IPO 项目、天津七一二通信广播股份有限公司 IPO 项目、中铝国际工程股份有限公司 IPO 项目、厦门钨业股份有限公司非公开发行股票项目、武汉华中数控股份有限公司非公开发行股票项目、南京埃斯顿自动化股份有限公司非公开发行股票项目、深圳市赢合科技股份有限公司非公开发行股票项目、中信重工机械股份有限公司发行股份购买资产并配套融资项目、中金黄金股份有限公司配股项目、中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票项目、中国石油化工股份有限公司销售板块引战混改项目、中信证券（浙江）分立重组项目等 A 股项目以及北京奕斯伟计算技术股份有限公司 H 股 IPO 项目、山东天岳先进科技股份有限公司 H 股 IPO 项目、徽商银行股份有限公司 H 股 IPO 项目、昆山丘钛微电子科技股份有限公司港股 IPO 项目、中国信达资产管理股份有限公司 H 股 IPO 项目等港股项目。其在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

陈泽，男，现任中信证券股份有限公司投资银行委员会高级副总裁，保荐代表人。曾负责或参与南京莱斯信息技术股份有限公司 IPO 项目、南京高华科技股份有限公司 IPO 项目、晶晨半导体（上海）股份有限公司 IPO 项目、西安奕斯伟材料科技股份有限公司 IPO 项目、南京埃斯顿自动化股份有限公司非公开发行股票项目、本钢板材股份有限公司可转债项目、长沙景嘉微电子股份有限公司非公开发行股票项目、安通控股股份有限公司非公开发行股票项目、览海医疗产业投资股份有限公司非公开发行股票项目、上海巴安水务股份有限公司非公开发行股票项目、北京君正集成电路股份有限公司发行股份购买资产及配套融资项目、冠福控股股份有限公司发行股份购买资产及配套融资、厦门三五互联科技股份有限公司发行股份购买资产及配套融资项目、河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金等。其在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（二）项目协办人及项目组其他成员情况

中信证券指定张锦沛作为燧原科技首次公开发行股票并在科创板上市项目的项目协办人，指定徐文鲁、宋杰、郑伊敏、金浩、于棚土、王琛、马豪、陈楷民、贾济舟、张津源、鲁培、赵悠作为燧原科技首次公开发行股票并在科创板上市项目的项目组成员。

张锦沛，男，现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁。曾负责或参与的项目包括西安奕斯伟材料科技股份有限公司 IPO 项目、沈阳富创精密设备股份有限公司 IPO 项目、科德数控股份有限公司 IPO 项目、长江存储科技有限责任公司财务顾问项目、科德数控股份有限公司非公开发行股票项目、广西柳工机械股份有限公司重大资产重组项目、湖南华菱钢铁股份有限公司重大资产重组项目、重庆钢铁股份有限公司重大资产重组项目、广西柳工机械股份有限公司混改项目等 A 股项目以及北京奕斯伟计算技术股份有限公司港股 IPO 项目、山东天岳先进科技股份有限公司 H 股 IPO 项目等港股项目。

（三）本次证券发行上市的项目人员联系方式

本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员执业情况联系方式如下：

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层

联系电话：010-60838888

三、保荐人与发行人存在的关联关系

（一）保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况

截至 2025 年 12 月 31 日，除保荐人中信证券因非主动投资，通过国方金浦等发行人直接股东存在极少量间接持股（穿透持股比例合计小于 0.01%）外，保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

此外，根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》及《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》的要求，科创板试行保荐人相关子公司“跟投”制度。保荐人将安排依法设立的相关子公司参与本次发行战略配售，并按照股票发行价格认购发行人首次公开发行股票数量 2%至 5%的股票，具体比例根据发行人首次公开发行股票的规模分档确定。保荐人及相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件。

（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份情况

除可能存在少量、正常的二级市场证券投资外，截至本上市保荐书签署日，发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方未持有保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份。

（三）保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况

截至本上市保荐书签署日，保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份的情况，不存在在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况。

（四）保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人的控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况

截至本上市保荐书签署日，保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人

的控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况。

（五）保荐人与发行人之间的其他关联关系。

截至本上市保荐书签署日，保荐人与发行人之间不存在其他关联关系。

四、保荐人内部审核程序和内核意见

（一）内核程序

中信证券设内核部，负责本机构投资银行类项目的内核工作。保荐人内部审核具体程序如下：

内核部将按照保荐项目所处阶段以及项目组的预约情况对项目进行现场内核。内核部在受理项目申报材料之后，将指派审核员分别从法律和财务角度对项目申请文件进行初审。同时内核部结合项目情况，有可能聘请外部律师和会计师等专业人士对项目申请文件进行审核，为本机构内核部提供专业意见支持。由内核部审核员召集该项目的签字保荐代表人、项目负责人履行问核程序，询问该项目的尽职调查工作情况，并提醒其未尽到勤勉尽责的法律后果。

内核审议在对项目文件和材料进行仔细研判的基础上，结合项目质量控制报告，重点关注审议项目是否符合法律法规、规范性文件和自律规则的相关要求，尽职调查是否勤勉尽责。发现审议项目存在问题和风险的，提出书面反馈意见，内核会召开前由内核部汇总出具项目内核报告。内核委员会以现场会议方式履行职责，以投票表决方式对内核会议审议事项作出审议。同意对外提交、报送、出具或披露材料和文件的决议应当至少经 $2/3$ 以上的参会内核委员表决通过。内核部对内核意见的答复、落实情况进行审核，确保内核意见在项目材料和文件对外提交、报送、出具或披露前得到落实。

（二）内核意见

2025 年 12 月 24 日，在中信证券大厦 21 层 2 号会议室召开了燧原科技 IPO 项目内核会，经全体参会内核委员投票表决，该项目通过了中信证券内核委员会的审议，同意将上海燧原科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目申请文件对外申报。

第三节 保荐人承诺事项

保荐人已按照法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，中信证券作出以下承诺：

一、保荐人有充分理由确信发行人符合法律法规和中国证监会及上海证券交易所有关证券发行上市的相关规定。

二、保荐人有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、保荐人有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理。

四、保荐人有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异。

五、保荐人保证所指定的保荐代表人及本保荐人的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查。

六、保荐人保证上市保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、保荐人保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范。

八、保荐人自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施，自愿接受上海证券交易所的自律监管。

九、保荐人自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施。

十、保荐人将遵守法律、行政法规和中国证监会对推荐证券上市的规定，自愿接受证券交易所的自律监管。

第四节 保荐人对本次证券发行上市的推荐意见

一、本机构对本次证券发行的推荐结论

中信证券根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规的规定，由项目组对发行人进行了充分的尽职调查，由内核会议进行了集体评审，认为：发行人具备《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》等相关法律法规规定的首次公开发行股票并在科创板上市的条件。

发行人具有自主创新能力和成长性，法人治理结构健全，经营运作规范；发行人主营业务突出，经营业绩高速增长，发展前景良好；本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策，符合发行人的经营发展战略，能够产生良好的经济效益，有利于推动发行人持续稳定发展。因此，保荐人同意对发行人首次公开发行股票并在科创板上市予以保荐。

二、发行人就本次证券发行履行的决策程序

（一）董事会决策程序

发行人第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案》等相关议案。

（二）股东会决策程序

发行人 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案》等相关议案。

综上，保荐人认为，发行人本次发行已获得了必要的批准和授权，履行了必要的决策程序，决策程序合法有效。

（三）保荐人意见

经核查，保荐人认为：上述董事会、股东会的召集和召开程序、召开方式、出席会议人员的资格、表决程序和表决内容符合《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》及发行人《公司章程》的相关规定，表决结果均合法、有效。发行人本次发行已经依据其进行阶段，取得了法律、法规和规范性文件所要求的发行人内部批准和授权，授权程序合法、内容明确具体，合法有效。

三、发行人符合科创板定位要求

（一）发行人符合科创板定位

1、公司符合行业领域要求

公司所属 行业领域	☒ 新一代信息技术	公司主要从事云端 AI 芯片及相关产品的研发、设计和销售。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业分类为“I65 软件和信息技术服务业”之“I6520 集成电路设计”
	☐ 高端装备	
	☐ 新材料	根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业为“1 新一代信息技术产业/1.3 新兴软件和新型信息技术服务”之“1.3.4 新型信息技术服务”之“6520 集成电路设计”
	☐ 新能源	
	☐ 节能环保	根据国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016 年），公司所从事的业务属于“1 新一代信息技术产业”中“1.3 电子核心基础产业”的“1.3.1 集成电路”领域
	☐ 生物医药	
	☐ 符合科创板定位的其他领域	根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年 4 月修订）》，公司所处行业属于第五条“（一）新一代信息技术领域”中的“半导体和集成电路”和“人工智能”领域

2、公司符合科创属性相关指标要求

公司符合《科创属性评价指引（试行）》、《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》规定的科创属性评价标准，具体情况如下：

科创属性评价标准	是否符合	指标情况
最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例 $\geq 5\%$ ，或最近三年累计研发投入金额 $\geq 8,000$ 万元	☒ 是 ☐ 否	2023 至 2025 年，公司累计研发投入 36.76 亿元，累计营业收入 20.14 亿元，最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例为 182.55%，超过 5%
研发人员占当年员工总数的比例不低于 10%	☒ 是 ☐ 否	截至 2025 年末，公司员工人数为 838 人，其中研发人员 643 人，研发人员占比为 76.73%，占比超 10%
应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利 7 项以上	☒ 是 ☐ 否	截至 2025 年末，公司拥有应用于主营业务并能够产业化的已授权发明专利 195 项，超过 7 项
最近三年营业收入复合增长率 $\geq 25\%$ ，或最近一年营业收入金额 ≥ 3 亿	☒ 是 ☐ 否	2023 至 2025 年，公司营业收入复合增长率为 81.32%，超过 25%。2025 年营业收入金额为 9.90 亿元

（二）发行人符合国家产业政策

公司主要从事云端 AI 芯片及相关产品的研发和销售。根据国家统计局发布的《中华人民共和国国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业分类为“I65 软

件和信息技术服务业”之“I6520 集成电路设计”。

根据国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016年），公司所从事的业务属于“1 新一代信息技术产业”中“1.3 电子核心基础产业”的“1.3.1 集成电路”领域。

根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业领域属于“1 新一代信息技术产业”之“1.3 新兴软件和新型信息技术服务”之“1.3.4 新型信息技术服务”之“6520 集成电路设计”行业，是国家重点发展的战略性新兴产业之一，公司符合国家产业政策和国家经济发展战略规划。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》，公司属于“新一代信息技术领域”中的“半导体和集成电路”和“人工智能”。

（三）保荐人核查过程及意见

1、访谈发行人研发部门负责人和核心技术人员，实地勘察发行人的研发场所和研发设备，查阅发行人研发管理相关制度等文件，了解发行人在研项目情况，核查发行人研发投入相关凭证；

2、了解公司主要产品的所属行业、下游应用领域、技术性能指标、研发方向及阶段、核心技术水平，查阅行业分类和行业研究报告；

3、取得并查阅公司与主要客户签署的销售合同、订单等文件，并对主要客户进行了走访，了解发行人产品的市场定位、技术水平、合作进展及应用前景；

4、结合发行人业务合同主要条款、同行业可比公司情况及会计准则规定，通过穿行测试、高管访谈、客户访谈、发询证函、现场走访等方式，对发行人营业收入确认进行核查；

5、查阅发行人员工花名册、研发部门架构、研发人员资历、研发人员认定标准等资料，调查发行人的研发模式和研发系统的设置和运行情况，查阅发行人报告期内研发项目资料，并核查研发人员薪酬情况及其费用归集情况；

6、访谈发行人的研发负责人，了解发行人的核心技术体系、技术原理、核心技术产品的性能表现，通过现场核查、网络核查等方式，核查发行人列报的专利权利归属、有效期限、有无权利受限或诉讼纠纷以及在核心技术中的应用情况；

7、结合发行人经审计的财务报告、业务合同主要条款、同行业可比公司情况及会计准则规定，通过穿行测试、发行人访谈、客户访谈、发询证函、现场核查等方式，核查发行人收入确认会计政策的合理性及执行的有效性、发行人营业收入的增长情况。

经核查，保荐人认为发行人符合国家产业政策；发行人拥有关键核心技术，科技创新能力突出，具备先进性，符合相关法律法规中对科创属性和科创板定位要求。

四、保荐人对发行人符合上市条件的说明

公司股票上市符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件，具体情况如下：

（一）发行人符合证监会规定的发行条件

1、发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十条的规定

经核查发行人的发起人协议、公司章程、发行人工商档案、《营业执照》等有关资料，保荐人认为，发行人系根据《公司法》在中国境内设立的股份有限公司，发行人的设立以及其他变更事项已履行了必要批准、验资、工商注册及变更登记等手续，发行人是依法设立且合法存续的股份有限公司。经核查发行人设立登记及历次工商变更的证明文件，发行人于 2018 年 3 月 19 日完成有限责任公司设立，并于 2023 年 12 月 20 日整体变更为股份有限公司。保荐人认为，发行人持续经营时间已在 3 年以上。

经核查发行人历次股东会、董事会和监事会的会议文件，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度，发行人自设立为股份有限公司以来已依据《公司法》等法律法规设立了股东会、董事会，在董事会下设置了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并建立了《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》等相关制度，建立健全了管理、生产、销售、财务、研发等内部组织机构和相应的内部管理制度。2025 年 11 月 25 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会以及修订<上海燧原科技股份有限公司章程>及<上海燧原科技股份有限公司股东会议事规则><上海燧原科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》，同意取消监事会，监事会的职权由董事会下属审计委员会行使。保荐人认为，发行人具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职

责。

2、发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告由注册会计师出具无保留意见的审计报告；发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保留结论的内部控制审计报告，符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十一条的规定

根据发行人的相关财务管理制度以及毕马威会计师出具的标准无保留意见的“毕马威华振审字第 2600818 号”《审计报告》，并核查发行人的原始财务报表，保荐人认为，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量。

根据发行人的财务管理制度和内部控制制度、毕马威会计师出具的“毕马威华振审字第 2600819 号”《内部控制审计报告》，并核查发行人的内部控制流程及其运行效果，保荐人认为，发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性。

3、发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力，符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十二条的规定

1、经核查发行人工商资料、主要资产权属证明文件、主要业务合同、对发行人董事和高级管理人员的访谈等资料，保荐人认为，发行人资产完整，资产、人员、财务、机构、业务独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

2、经核查发行人历次股东会、董事会会议文件，并核查发行人的实际经营情况，保荐人认为，发行人主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，最近 2 年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化；自公司成立以来，控股股东和实际控制人所持发行人的股份权属清晰，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，最近二年实际控制人没有发生变更。

3、经核查发行人财产清单、主要资产的权属证明文件等资料，结合与发行人管理层的访谈，并根据发行人律师所出具的《法律意见书》，保荐人认为，发行人不存在涉

及主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的的事项。

4、发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策，符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十三条的规定

经核查发行人的《营业执照》、主要业务合同、所在行业管理体制和行业政策，取得的工商、税务、社会保障及住房公积金等方面主管机构出具的有关证明文件，并进行公开信息查询，保荐人认为，最近三年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

经核查发行人董事和高级管理人员提供的个人简历、无犯罪记录证明及其分别出具的相关承诺，并核查股东会、董事会、审计委员会运营记录，公司董事、审计委员会委员和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形。

（二）公司发行后的股本总额不低于人民币 3,000 万元

本次发行前公司总股本为 38,731.6555 万股，公司本次拟向社会公众发行不低于 4,303.5173 万股且不超过 6,834.9980 万股（不含超额配售）。本次发行后公司股本总额不低于 4,303.5173 万股且不超过 6,834.9980 万股（不含超额配售）。

（三）公司股本总额超过 4 亿元，公开发行股份的比例为 10%以上

本次发行前公司总股本为 38,731.6555 万股，公司本次拟向社会公众发行不低于 4,303.5173 万股且不超过 6,834.9980 万股（不含超额配售），不低于本次发行后公司总股本的 10%且不超过本次发行后公司总股本的 15%。

（四）市值及财务指标符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的标准

公司选择适用《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.1 条市值及财务指标中的第（四）项标准，即“（四）预计市值不低于人民币 30 亿元，且最近一年营业收

入不低于人民币 3 亿元”，具体情况如下：

1、市值结论

公司最近一次外部融资估值情况及可比公司估值情况，公司预计市值不低于 30 亿元。

2、财务指标

公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度实现营业收入 30,118.74 万元、72,238.74 万元、99,016.00 万元，公司最近一年营业收入超过 3 亿元。

3、标准适用判定

公司结合自身规模、经营情况、盈利情况等因素，选择适用《上海证券交易所科创板股票上市规则》2.1.2 条的第四项上市标准，即“（四）预计市值不低于人民币 30 亿元，且最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元”。

综上所述，公司符合所选择的上市标准

（五）保荐意见

本保荐人根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》《保荐人尽职调查工作准则》等法规的规定，对发行人进行了充分的尽职调查，由内核会议进行了集体评审，认为：

发行人具备《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定的首次公开发行股票并在科创板上市的条件，发行人行业领域归类和科创属性符合科创板定位要求；发行人具有自主创新能力和成长性，法人治理结构健全，经营运作规范；发行人主营业务突出，经营业绩优良，发展前景良好；本次发行募集资金投资项目符合发行人的经营发展战略，有利于推动发行人持续稳定发展。因此，本保荐人同意对发行人首次公开发行股票并在科创板上市予以保荐。

第五节 上市后持续督导工作安排

一、持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后 3 个完整会计年度；

二、有充分理由确信发行人可能存在违法违规行为以及其他不当行为的，应督促发行人作出说明并限期纠正；情节严重的，应当向中国证监会、上海证券交易所报告；

三、按照中国证监会、上海证券交易所信息披露规定，对发行人违法违规的事项发表公开声明；

四、督导发行人有效执行并完善防止大股东及其他关联方违规占用发行人资源的制度；

五、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内部控制制度；

六、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；

七、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件；

八、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项；

九、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见；

十、中国证监会规定及保荐协议约定的其他工作。

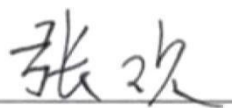
（以下无正文）

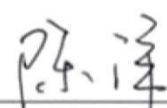
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海燧原科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》之签章页）

项目协办人：


张锦沛

保荐代表人：


张 欢


陈 泽

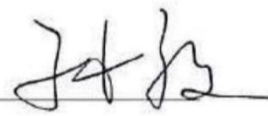


（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海燧原科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》之签章页）

内核负责人：


朱 洁

保荐业务负责人：


孙 毅



（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海燧原科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》之签章页）

董事长、法定代表人：


张佑君

中信证券股份有限公司

2026年6月7日